

## TEST & BURN-IN FASSUNGEN

SIP • DIP • PLCC • SOP • QFP • PGA • BGA ... *Serie YA*

alle Raster

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Programm an TEST- und BURN-IN Fassungen für fast alle Gehäusegrößen, Ausführungen und Polzahlen an.

Alle Fassungen sind für den Testeinsatz konzipiert und daher für hohe Steckzyklen und lange Lebensdauer ausgelegt.

Unterschiedliche Anwendungen erfordern verschiedene technische Lösungen wie z.B.: Klappdeckelfassungen, Spring-Load-Fassungen ...

Bezeichnung	Beschreibung	Raster (Pitch)	Polzahl
<b>SIP</b>	Single Inline Package	1,27 ... 2,0	7 ... 56
<b>SIMM</b>	Single Inline Memory Module	1,27 • 2,54	30 ... 100
<b>DIMM</b>	Dual Inline Memory Module	0,8 • 1,27	72, 144, 160, 168
<b>ZIP</b>	Zig-Zag Inline Package	1,27 ... 1,778	12 ... 60
<b>DIP</b>	Dual Inline Package	2,54	8 ... 64
<b>SDIP</b>	Shrink Dual Inline Package	1,778	20 ... 64
<b>SOJ</b>	Small Outline J-Lead Package	1,27	20 ... 44
<b>SOP</b>	Small Outline Package	0,8 ... 1,27	8 ... 56
<b>SSOP</b>	Shrink Small Outline Package	0,635 ... 0,65	14 ... 72
<b>TSOP</b>	Thin Small Outline Package	0,5 ... 0,8	24 ... 50
<b>QFP</b>	Quad Flat Package	0,4 ... 1,0	32 ... 304
<b>PQFP</b>	Plastic Quad Flat Package	0,4 ... 1,0	32 ... 304
<b>TQFP</b>	Thin Quad Flat Package	0,4 ... 1,0	32 ... 304
<b>BQFP</b>	Bumper Quad Flat Package	0,64	84 ... 164
<b>PLCC</b>	Plastic Lead Chip Carrier	1,27	20 ... 124
<b>LCC</b>	Leadless Chip Carrier	1,27	44 ... 68
<b>PGA</b>	Pin Grid Array	1,27 ... 2,54	73 ... 625
<b>BGA</b>	Ball Grid Array	0,8 ... 1,27	48 ... 2116

**Bitte fordern Sie den Spezialkataloge „Test- & Burn-In Fassungen“ oder „Produktionssockel“ an !**

